

巻頭言

三井住友建設技術開発センター報告第 10 号の発刊にあたり、ご挨拶申し上げます。

昨年度のわが国経済は、東日本大震災や電力事情の影響により、一時的に大きく落ち込みましたが、今年度は復旧・復興の動きにも支えられ、住宅等の内需にも回復の兆しが見え始めています。

しかしながら、欧州債務問題をきっかけとした世界的な景気停滞の懸念も色濃く、景気の先行きはなお、不透明なものとなっています。

国内の建設投資においては、円高の定着による国内設備投資の低迷や震災復興に伴う資材・労務の高騰が大きな懸念材料となっています。

弊社におきましては、今年度は透明性の高い経営と本業収益力、信用力を強化するとともに、新たな成長戦略を打ち出すことで持続可能な企業活動を展開すべく策定した「第 3 次中期経営計画」（平成 22 年 5 月策定）の最終年度に入っています。

技術開発においては、上記の計画で当社のコア分野として位置づけている PC 橋ならびに超高層住宅のさらなる「高品質化」・「高機能化」を推進しています。これらに加え、東日本大震災を契機に再認識された耐震性に優れた公共施設および住宅の実現、さらには既設構造物の耐震補強などに資する技術開発を鋭意進めております。

今後も引き続き、「技術の信頼、受注の拡大、利益の向上を目指し、顧客ニーズに応える技術開発をタイムリーに推進する」という基本方針に即した技術開発を行うとともに、「社会のニーズ」に対して、どのような価値を提供できるかを問い続けていく所存です。

このような技術開発方針の下、このたび平成 23 年度分の弊社技術開発について、「技術開発センター報告」として取りまとめさせていただきました。

なお、本号は 2004 年 3 月に「三井住友建設技術研究所報告」として、第 1 号を発刊して以来、10 巻目となります。技術開発センター報告を多くの方々にご覧頂き、ご批評を賜れば幸いです。

2012 年 10 月

執行役員
技術研究開発本部長
西 村 憲 義